

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2014년 6월 19일 (19.06.2014)



(10) 국제공개번호
WO 2014/092401 A1

- (51) 국제특허분류:
C08L 63/00 (2006.01) C08G 59/22 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01) H05K 1/03 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2013/011312
- (22) 국제출원일: 2013년 12월 6일 (06.12.2013)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2012-0144787 2012년 12월 12일 (12.12.2012) KR
- (71) 출원인: 엘지이노텍 주식회사 (LG INNOTEK CO., LTD.) [KR/KR]; 100-714 서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어, Seoul (KR).
- (72) 발명자: 윤여은 (YOON, Yeo Eun); 100-714 서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어, Seoul (KR). 김명정 (KIM, Myeong Jeong); 100-714 서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어, Seoul (KR). 윤성진 (YUN, Sungjin); 100-714 서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어, Seoul (KR). 주상아 (JU, Sanga); 100-714 서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어, Seoul (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 다나 (DANA PATENT LAW FIRM); 135-936 서울시 강남구 역삼로 3길 11 광성빌딩 신관 4-6층, Seoul (KR).

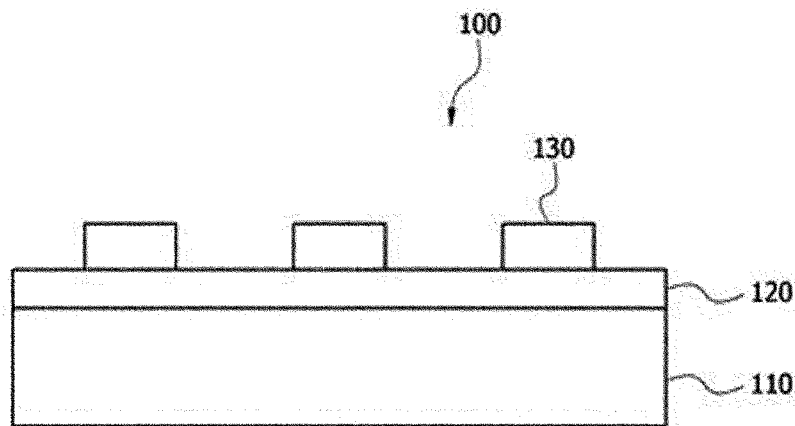
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION, AND PRINTED CIRCUIT BOARD USING SAME

(54) 발명의 명칭 : 수지 조성물 및 이를 이용한 인쇄 회로 기판



(57) Abstract: According to one embodiment of the present invention, an epoxy resin composition comprises: a resin including an epoxy compound, triethylenediamine, diphenylphosphine and/or tetraphenylborate; a curing agent including diaminodiphenylsulfone, ethylenediamine, diaminopropane, methanediamine, phenylenediamine and/or triethanolamine; and an inorganic filler, wherein the inorganic filler includes at least two alumina (Al_2O_3) groups classified by particle size.

(57) 요약서: 본 발명의 한 실시예에 따른 에폭시 수지 조성물은 에폭시 화합물, 트리에틸렌디아민, 디페닐포스핀 및 테트라페닐보레이트 중 적어도 하나를 포함하는 수지, 디아미노디페닐설햄, 에틸렌디아민, 디아미노프로판, 메탄디아민, 페닐렌디아민 및 트리에탄올아민 중 적어도 하나를 포함하는 경화제, 그리고 무기 충전재를 포함하고, 상기 무기 충전재는 입자의 크기에 따라 구분된 적어도 2 이상의 알루미늄($Alumina, Al_2O_3$)그룹을 포함한다

WO 2014/092401 A1

명세서

발명의 명칭: 수지 조성물 및 이를 이용한 인쇄 회로 기판 기술분야

- [1] 본 발명은 수지 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 수지 조성물 및 이를 이용한 인쇄 회로 기판에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 전자 기기에 이용되는 다양한 전자 부품은, 예를 들면 발열 소자일 수 있다. 발열 소자가 방출하는 열은 전자 기기의 성능 및 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있다. 전자 부품의 고집적화 및 고용량화에 따라, 전자 부품이 탑재되는 인쇄 회로 기판 또는 전자 부품이 접합되는 소재의 방열 문제에 대한 관심이 더욱 커지고 있다.
- [3] 방열 성능을 높이기 위하여, 비전도성 방열층을 포함하는 방열 기판이 제안되고 있다. 비전도성 방열층은, 예를 들면 ZnO 계 세라믹 재료를 주성분으로 하되, Bi₂O₃, PrxOy(Prasedymiumoxide), 기타 첨가제 등을 포함하는 조성물로 이루어질 수 있다(한국공개특허 제2011-0027807호).
- [4] 그러나, 이와 같은 비전도성 방열층의 열전도성이 충분하지 못하여, 소자가 방출하는 다량의 열에 대응하기 어려운 문제가 있다.

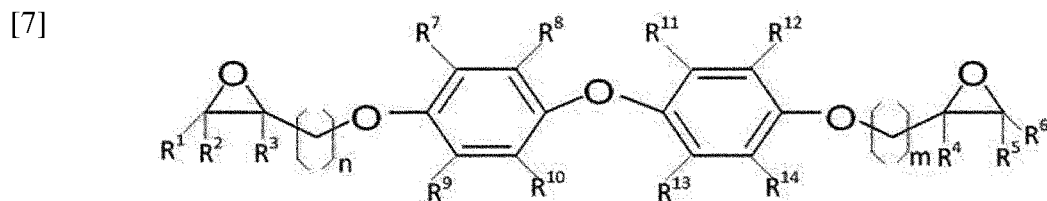
발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [5] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 수지 조성물 및 이를 이용한 인쇄 회로 기판을 제공하는 것이다.

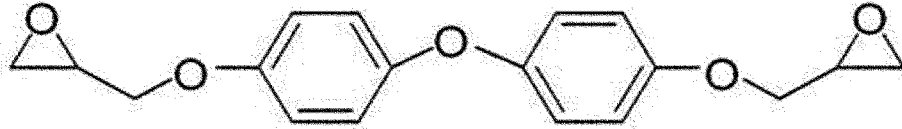
과제 해결 수단

- [6] 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물은 하기 화학식의 에폭시 화합물, 트리에틸렌디아민, 디페닐포스핀 및 테트라페닐보레이트 중 적어도 하나를 포함하는 수지, 디아미노디페닐설폰, 에틸렌디아민, 디아미노프로판, 메탄디아민, 페닐렌디아민 및 트리에탄올아민 중 적어도 하나를 포함하는 경화제, 그리고 무기 충전제를 포함하고, 상기 무기 충전제는 입자의 크기에 따라 구분된 적어도 2이상의 알루미나(Alumina, Al₂O₃)그룹을 포함한다.



- [8] 여기서, R¹내지 R¹⁴은 각각 H, Cl, Br, F, C₁~C₃알킬, C₂~C₃알켄, C₂~C₃알킨으로 구성된 그룹에서 선택될 수 있다. 여기서, m, n은 각각 1, 2 또는 3일 수 있다.
- [9] 상기 수지는 하기 화학식의 에폭시 화합물을 포함할 수 있다.

[10]



[11] 상기 수지 조성물에 대하여 상기 화학식 2의 에폭시 화합물은 3 내지 40 wt%로 포함되고, 상기 경화제는 0.5 내지 30 wt%로 포함되며, 상기 무기 충전제는 40 내지 96.5 중량부wt%로 포함될 수 있다.

[12] 상기 무기 충전제는 입도가 $0.1\mu\text{m}$ 이상이고 $10\mu\text{m}$ 미만인 제1 알루미나 그룹, 입도가 $10\mu\text{m}$ 이상이고 $30\mu\text{m}$ 미만인 제2 알루미나 그룹 및 입도가 $30\mu\text{m}$ 이상이고 $60\mu\text{m}$ 이하인 제3 알루미나 그룹을 포함할 수 있다.

[13] 상기 제1 알루미나 그룹은 전체 수지 조성물의 10 내지 66.5wt%로 포함되고, 상기 제2 알루미나 그룹은 전체 수지 조성물의 10 내지 66.5wt%로 포함되며, 상기 제3 알루미나 그룹은 전체 수지 조성물의 20 내지 76.5wt%로 포함될 수 있다.

[14] 상기 제1 알루미나 그룹과 상기 제2 알루미나 그룹의 함량 비는 1:1 내지 2이고, 상기 제1 알루미나 그룹과 상기 제3 알루미나 그룹의 함량 비는 1:1.5 내지 5.5일 수 있다.

[15] 본 발명의 한 실시예에 따른 인쇄 회로 기판은 금속 플레이트, 상기 금속 플레이트 상에 형성되는 절연층, 그리고 상기 절연층 상에 형성되는 회로 패턴을 포함하고, 상기 절연층은 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물로 이루어진다.

발명의 효과

[16] 본 발명의 실시예에 따르면, 수지 조성물을 얻을 수 있다. 이를 이용하여 열전도성이 높은 방열층을 얻을 수 있으며, 전자 부품이 탑재되는 전자 기기의 신뢰도와 방열 성능을 높일 수 있다.

도면의 간단한 설명

[17] 도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 인쇄 회로 기판의 단면도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

[18] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[19] 제2, 제1 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제2 구성요소는 제1 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제1 구성요소도 제2 구성요소로

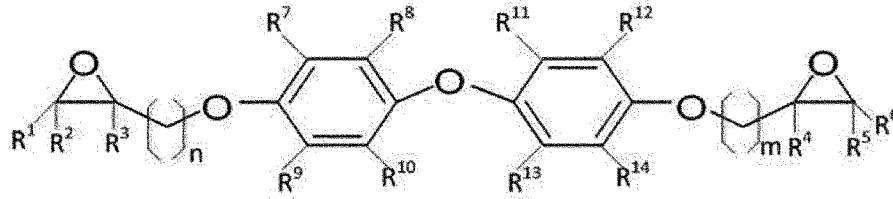
명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.

- [20] 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [21] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
- [22] 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우 뿐만 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다.
- [23] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
- [24] 본 명세서에서 wt%는 중량부로 대체될 수 있다.
- [25] 본 발명의 한 실시예에 따르면, 수지, 경화제 및 무기 충전제를 포함하며, 무기 충전제는 입자의 크기에 따라 구분된 적어도 2 이상의 알루미나(Alumina, Al_2O_3) 그룹을 포함하는 수지 조성물을 제공한다.
- [26] 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물은 전체 수지 조성물에 대하여 3wt% 내지 40wt%, 바람직하게는 3wt% 내지 30wt%, 더욱 바람직하게는 3wt% 내지 20wt%의 수지를 포함할 수 있다. 수지가 전체 수지 조성물의 3wt% 이하로 함유된 경우, 밀착성이 나빠질 수 있다. 수지가 전체 수지 조성물의 40wt% 이상으로 함유된 경우 두께 조절이 힘들 수 있다. 이때, 수지 조성물은 전체 수지 조성물에 대하여 3wt% 이상의 결정성 에폭시 수지를 포함할 수 있다. 결정성 에폭시 수지가 전체 수지 조성물의 3wt%보다 적게 포함되는 경우, 결정화되지 않아 열전도 효과가 낮을 수 있다.
- [27] 여기서, 결정성 에폭시 수지는 하기 화학식 1과 같은 메조젠(mesogen) 화합물일 수 있다. 메조젠(mesogen)은 액정(liquid crystal)의 기본 단위이며, 강성(rigid) 구조를 포함한다. 메조젠은, 예를 들면 비페닐(biphenyl), 페닐벤조에이트(phenylbenzoate), 나프탈렌(naphthalene)과 같은 강성 구조를

포함할 수 있다.

[28] [화학식 1]

[29]

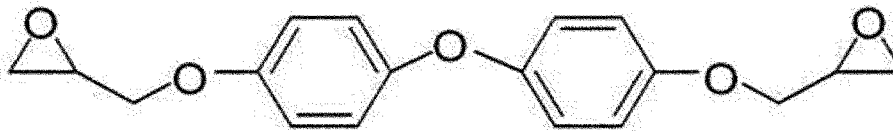


[30] 여기서, R¹ 내지 R¹⁴은 각각 H, Cl, Br, F, C₁~C₃알킬, C₂~C₃알켄, C₂~C₃알킨으로 구성된 그룹에서 선택될 수 있다. 여기서, m, n은 각각 1, 2 또는 3일 수 있다.

[31] 결정성 에폭시 수지는 하기 화학식 2와 같이 나타낼 수도 있다.

[32] [화학식 2]

[33]



[34] 화학식 2에 따른 에폭시 수지(이하, 4,4'-biphenolether diglycidyl ether라 지칭할 수 있다)의 에폭시 당량은 120 내지 300, 바람직하게는 150 내지 200일 수 있다. 화학식 2에 따른 에폭시 수지의 물성은 녹는점(melting point)이 158°C이고, ¹H-NMR(CDCl₃-d6, ppm)결과는 δ=8.58(s, 2H), δ=8.17-8.19(d, 4H), δ=7.99-8.01(d, 4H), δ=7.33(s, 4H), δ=4.69-4.72(d, 1H), δ=4.18-4.22(m, 1H), δ=3.36-3.40(m, 1H), δ=2.92-2.94(m, 1H) 및 δ=2.74-2.77(m, 1H)이다. 녹는점은 시차 주사 열량 분석 장치(TA사 제품 DSC Q100)를 사용하여 승온속도 10°C/분으로 측정하였다. NMR은 CDCl₃-d6에 용해시킨 후 H-NMR 측정하였다.

[35] 화학식 2에 따른 에폭시 수지는 상온에서 결정성을 가진다. 결정성의 발현은 시차 주사 열량 분석에서 결정의 흡열 피크를 이용하여 확인할 수 있다. 이때, 흡열 피크는 복수의 피크 또는 브로드한 피크로 나타날 수 있고, 가장 낮은 온도의 흡열 피크가 60 °C이상, 바람직하게는 70 °C이상이고, 가장 높은 온도의 흡열 피크가 120 °C이하, 바람직하게는 100°C이하일 수 있다.

[36] 한편, 수지 조성물은 화학식 1 또는 화학식 2에 따른 결정성 에폭시 수지 외에, 분자 중 에폭시기를 2개 이상 가지는 통상의 다른 비결정성 에폭시 수지를 더 포함할 수 있다. 결정성 에폭시 수지 외에 비결정성 에폭시 수지를 더 포함하면, 상온 안정성을 높일 수 있다.

[37] 비결정성 에폭시 수지는, 예를 들면 비스페놀 A, 비스페놀 F, 3,3',5,5'-테트라메틸-4,4'-디히드록시디페닐메탄, 4,4'-디히드록시디페닐술폰, 4,4'-디히드록시디페닐술폰피드, 4,4'-디히드록시디페닐케톤, 플루오렌비스페놀, 4,4'-비스페놀, 3,3',5,5'-테트라메틸-4,4'-디히드록시비페닐, 2,2'-비스페놀, 레조르신, 카테콜, t-부틸카테콜, 히드로퀴논, t-부틸히드로퀴논, 1,2-디히드록시나프탈렌, 1,3-디히드록시나프탈렌, 1,4-디히드록시나프탈렌, 1,5-디히드록시나프탈렌, 1,6-디히드록시나프탈렌, 1,7-디히드록시나프탈렌, 1,8-디히드록시나프탈렌,

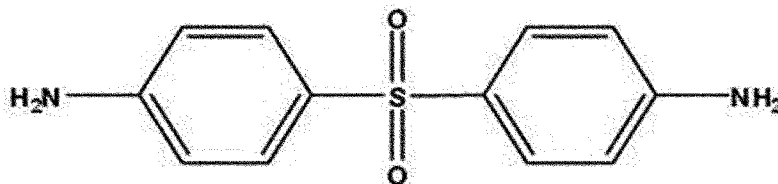
2,3-디히드록시나프탈렌, 2,4-디히드록시나프탈렌, 2,5-디히드록시나프탈렌, 2,6-디히드록시나프탈렌, 2,7-디히드록시나프탈렌, 2,8-디히드록시나프탈렌, 상기 디히드록시나프탈렌의 알릴화물 또는 폴리알릴화물, 알릴화비스페놀A, 알릴화비스페놀F, 알릴화페놀노볼락 등의 2가의 페놀류, 혹은 페놀노볼락, 비스페놀A노볼락, o-크레졸노볼락, m-크레졸노볼락, p-크레졸노볼락, 크실레놀노볼락, 폴리-p-히드록시스티렌, 트리스-(4-히드록시페닐)메탄, 1,1,2,2-테트라키스(4-히드록시페닐)에탄, 플루오로글리시놀, 피로갈롤, t-부틸피로갈롤, 알릴화피로갈롤, 폴리알릴화피로갈롤, 1,2,4-벤젠트리올, 2,3,4-트리히드록시벤조페논, 페놀아랄킬수지, 나프톨아랄킬수지, 디시클로펜타디엔계 수지 등의 3가 이상의 페놀류, 테트라브로모비스페놀A 등의 할로겐화비스페놀류로부터 유도되는 글리시딜에테르화물 및 이들로부터 선택된 혼합물 중 하나일 수 있다.

[38] 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물은 트리에틸렌디아민, 디페닐포스핀, 테트라페닐보레이트 및 이들로부터 선택된 혼합물 중 적어도 하나의 수지를 포함할 수도 있다.

[39] 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물은 전체 수지 조성물에 대하여 0.5wt% 내지 30wt%의 경화제가 포함될 수 있다. 경화제가 전체 수지 조성물의 0.5wt% 이하로 함유된 경우, 밀착성이 나빠질 수 있다. 그리고, 경화제가 전체 수지 조성물의 30wt% 이상 함유된 경우, 두께 조절이 힘들 수 있다. 수지 조성물에 포함되는 경화제는 하기 화학식 3과 같은 4, 4'-디아미노디페닐설폰일 수 있다. 화학식 3의 경화제는 화학식 2의 에폭시 수지와 반응하여 에폭시 수지 조성물의 열적 안정성을 높일 수 있다.

[40] [화학식 3]

[41]



[42] 4, 4'-디아미노디페닐설폰 외에, 페놀계 경화제, 아민계 경화제, 산무수물계 경화제 중 적어도 하나가 더 포함될 수도 있다.

[43] 페놀계 경화제는, 예를 들면 비스페놀A, 비스페놀F, 4,4'-디히드록시디페닐메탄, 4,4'-디히드록시디페닐에테르, 1,4-비스(4-히드록시페녹시)벤젠, 1,3-비스(4-히드록시페녹시)벤젠, 4,4'-디히드록시디페닐설피드, 4,4'-디히드록시디페닐케톤, 4,4'-디히드록시디페닐설폰, 4,4'-디히드록시비페닐, 2,2'-디히드록시비페닐, 10-(2,5-디히드록시페닐)-10H-9-옥사-10-포스파페난트렌-10-옥사이드, 페놀노볼락, 비스페놀A노볼락, o-크레졸노볼락, m-크레졸노볼락, p-크레졸노볼락, 크실레놀노볼락, 폴리-p-히드록시스티렌, 히드로퀴논,

레조르신, 카테콜, t-부틸카테콜, t-부틸히드로퀴논, 플루오로글리시놀, 피로갈롤, t-부틸피로갈롤, 알릴화피로갈롤, 폴리알릴화피로갈롤, 1,2,4-벤젠트리올, 2,3,4-트리히드록시벤조페논, 1,2-디히드록시나프탈렌, 1,3-디히드록시나프탈렌, 1,4-디히드록시나프탈렌, 1,5-디히드록시나프탈렌, 1,6-디히드록시나프탈렌, 1,7-디히드록시나프탈렌, 1,8-디히드록시나프탈렌, 2,3-디히드록시나프탈렌, 2,4-디히드록시나프탈렌, 2,5-디히드록시나프탈렌, 2,6-디히드록시나프탈렌, 2,7-디히드록시나프탈렌, 2,8-디히드록시나프탈렌, 상기 디히드록시나프탈렌의 알릴화물 또는 폴리알릴화물, 알릴화비스페놀A, 알릴화비스페놀F, 알릴화페놀노볼락, 알릴화피로갈롤 및 이들로부터 선택된 혼합물 중 하나일 수 있다.

- [44] 아민계 경화제는, 예를 들면 지방족 아민류, 폴리에테르폴리아민류, 지환식 아민류, 방향족 아민류 등일 수 있으며, 지방족 아민류로서는, 에틸렌디아민, 1,3-디아미노프로판, 1,4-디아미노프로판, 헥사메틸렌디아민, 2,5-디메틸헥사메틸렌디아민, 트리메틸헥사메틸렌디아민, 디에틸렌트리아민, 이미노비스프로필아민, 비스(헥사메틸렌)트리아민, 트리에틸렌테트라민, 테트라에틸렌펜타민, 펜타에틸렌헥사민, N-히드록시에틸에틸렌디아민, 테트라(히드록시에틸)에틸렌디아민 등을 들 수 있다.
- 폴리에테르폴리아민류로서는, 트리에틸렌글리콜디아민, 테트라에틸렌글리콜디아민, 디에틸렌글리콜비스(프로필아민), 폴리옥시프로필렌디아민, 폴리옥시프로필렌트리아민류 및 이들로부터 선택된 혼합물 중 하나일 수 있다. 지환식 아민류로서는, 이소포론디아민, 메타센디아민, N-아미노에틸피페라진, 비스(4-아미노-3-메틸디시클로헥실)메탄, 비스(아미노메틸)시클로헥산, 3,9-비스(3-아미노프로필)2,4,8,10-테트라옥사스피로(5,5)운데칸, 노르보르넨디아민 등을 들 수 있다. 방향족 아민류로서는, 테트라클로로-p-크실렌디아민, m-크실렌디아민, p-크실렌디아민, m-페닐렌디아민, o-페닐렌디아민, p-페닐렌디아민, 2,4-디아미노아니솔, 2,4-톨루엔디아민, 2,4-디아미노디페닐메탄, 4,4'-디아미노디페닐메탄, 4,4'-디아미노-1,2-디페닐에탄, 2,4-디아미노디페닐술폰, m-아미노페놀, m-아미노벤질아민, 벤질디메틸아민, 2-디메틸아미노메틸)페놀, 트리에탄올아민, 메틸벤질아민, -(m-아미노페닐)에틸아민, -(p-아미노페닐)에틸아민, 디아미노디에틸디메틸디페닐메탄, '-비스(4-아미노페닐)-p-다이소프로필벤젠 및 이들로부터 선택된 혼합물 중 하나일 수 있다.

- [45] 산무수물계 경화제는, 예를 들면 도데세닐무수숙신산, 폴리아디핀산무수물, 폴리아젤라인산무수물, 폴리세바신산무수물, 폴리(에틸옥타데칸이산)무수물, 폴리(페닐헥사데칸이산)무수물, 메틸테트라히드로무수프탈산, 메틸헥사히드로무수프탈산, 헥사히드로무수프탈산, 무수메틸하이믹산,

테트라히드로무수프탈산, 트리알킬테트라히드로무수프탈산,
 메틸시클로헥센디카르본산무수물, 메틸시클로헥센테트라카르본산무수물,
 무수프탈산, 무수트리멜리트산, 무수피로멜리트산,
 벤조페논테트라카르본산무수물, 에틸렌글리콜비스트리멜리테이트,
 무수헥산, 무수나딕산, 무수메틸나딕산,
 5-(2,5-디옥소테트라히드로-3-푸라닐)-3-메틸-3-시클로헥산-1,2-디카르본산무수물,
 3,4-디카르복시-1,2,3,4-테트라히드로-1-나프탈렌숙신산이무수물,
 1-메틸-디카르복시-1,2,3,4-테트라히드로-1-나프탈렌숙신산이무수물 및
 이들로부터 선택된 혼합물 중 하나일 수 있다.

[46] 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물은 에틸렌디아민, 1,3-디아미노프로판, 메탄디아민, m-페닐렌디아민, 트리에탄올아민 및 이들로부터 선택된 혼합물 중 적어도 하나의 경화제를 포함할 수도 있다.

[47] 수지 조성물은 경화 촉진제를 더 포함할 수도 있다.

[48] 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물은 전체 수지 조성물에 대하여 40wt% 내지 96.5wt%의 무기 충전제를 포함할 수 있다. 무기 충전제가 40wt%보다 적게 포함되면, 수지 조성물의 고열전도성, 저열팽창성 및 고온내열성 등이 보장되지 않는다. 고열전도성, 저열팽창성 및 고온내열성은 무기 충전제의 첨가량이 많을수록 좋은데, 그 체적 분율에 따라 향상되는 것은 아니며, 특정 첨가량부터 비약적으로 향상된다. 다만, 무기 충전제의 첨가량이 96.5wt%보다 많이 포함되면, 점도가 높아져 성형성이 약화된다.

[49] 무기 충전제는 알루미나(Alumina, Al_2O_3)를 포함한다. 이때, 무기 충전재로 이용되는 알루미나는 입자의 크기에 따라 구분된 적어도 2 이상의 그룹을 포함할 수 있다. 예를 들어, 무기 충전제는 입자의 지름이 $0.1\mu m$ 이상이고 $10\mu m$ 미만, 바람직하게는 $0.5\mu m$ 내지 $5\mu m$ 인 알루미나 그룹, 입자의 지름이 $10\mu m$ 이상이고 $30\mu m$ 미만, 바람직하게는 $15\mu m$ 내지 $25\mu m$ 인 알루미나 그룹 및 입자의 지름이 $30\mu m$ 이상이고 $60.0\mu m$ 이하, 바람직하게는 $30.0\mu m$ 내지 $45.0\mu m$ 인 알루미나 그룹을 포함할 수 있다.

[50] 입자의 지름이 $0.1\mu m$ 이상이고 $10\mu m$ 미만 알루미나 그룹은 전체 수지 조성물의 10wt% 내지 66.5wt%만큼 포함될 수 있다. 입자의 지름이 $10\mu m$ 이상이고 $30\mu m$ 미만인 알루미나 그룹은 전체 수지 조성물의 10wt% 내지 66.5wt%만큼 포함될 수 있다. 입자의 지름이 $30\mu m$ 이상이고 $60.0\mu m$ 이하인 알루미나 그룹은 전체 수지 조성물의 20wt% 내지 76.5wt%, 바람직하게는 30wt% 내지 70wt%, 더욱 바람직하게는 40wt% 내지 65wt%만큼 포함될 수 있다.

[51] 입자의 지름이 $0.1\mu m$ 이상이고 $10\mu m$ 미만인 알루미나 그룹과 입자의 지름이 $10\mu m$ 이상이고 $30\mu m$ 미만인 알루미나 그룹의 함량 비, 즉 중량비는 1:1 내지 2이고, 입자의 지름이 $0.1\mu m$ 이상이고 $10\mu m$ 미만인 알루미나 그룹과 입자의 지름이 $30\mu m$ 이상이고 $60.0\mu m$ 이하인 알루미나 그룹의 함량 비는 1대 1.5 내지 5.5일 수 있다. 알루미나 그룹 별 함량 비가 이와 같으면, 입자의 크기가 큰

알루미나(예, 입자의 지름이 30.0 μm 내지 60.0 μm 인 알루미나 그룹)를 이용하여 체적비를 향상시키며, 입자의 크기가 중간이거나 작은 알루미나(예, 입자의 지름이 0.1 μm 이상이고 10 μm 미만인 알루미나 그룹 및 입자의 지름이 10 μm 이상이고 30 μm 미만인 알루미나 그룹)를 골고루 채워 공극을 줄임으로써 열 전달을 위한 접촉 경로(contact path)를 최대화시킬 수 있다. 이에 따라, 열전도도를 높일 수 있다.

[52] 또한, 입자의 크기가 큰 알루미나(예, 입자의 지름이 30.0 μm 내지 60.0 μm 인 알루미나 그룹)를 입자의 크기가 중간이거나 작은 알루미나(예, 입자의 지름이 0.1 μm 이상이고 10 μm 미만인 알루미나 그룹 및 입자의 지름이 10 μm 이상이고 30 μm 미만인 알루미나 그룹)에 비하여 더 많이 포함시킬 경우, 열전도도를 더욱 높일 수 있다.

[53] 한편, 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물은 전체 수지 조성물에 대하여 0.1wt% 내지 2wt%, 바람직하게는 0.5wt% 내지 1.5wt%의 첨가제를 포함할 수 있다. 첨가제는, 예를 들면 페녹시(phenoxy), 하이퍼브랜치드 폴리에스터(hyperbranched polyester)일 수 있다. 첨가제가 0.1wt%보다 낮게 첨가되면 요구하는 특성(예, 점착력)을 얻기 어렵고, 2wt%보다 높게 첨가되면 점도 상승으로 인하여 성형성이 악화된다.

[54] 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물을 섬유 기재나 글라스 기재에 코팅 또는 함침시키고, 가열에 의하여 반경화시킴으로써 프리프레그(prepreg)를 제조할 수 있다.

[55] 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물은 인쇄 회로 기판에 적용될 수 있다. 도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 인쇄 회로 기판의 단면도이다.

[56] 도 1을 참조하면, 인쇄 회로 기판(100)은 금속 플레이트(110), 절연층(120) 및 회로 패턴(130)을 포함한다.

[57] 금속 플레이트(110)는 구리, 알루미늄, 니켈, 금, 백금 및 이들로부터 선택된 합금으로 이루어질 수 있다.

[58] 금속 플레이트(110) 상에는 본 발명의 한 실시예에 따른 에폭시 수지 조성물로 이루어진 절연층(120)이 형성된다.

[59] 절연층(120) 상에는 회로 패턴(130)이 형성된다.

[60] 본 발명의 한 실시예에 따른 수지 조성물을 절연층으로 이용함으로써, 방열 성능이 우수한 인쇄 회로 기판을 얻을 수 있다.

[61] 이하, 실시예 및 비교예를 이용하여 더욱 구체적으로 설명한다.

[62] <실시예 1>

[63] 화학식 2의 결정성 에폭시 화합물 11wt%, 4, 4'-디아미노디페닐설폰 8wt%, 하이퍼브랜치드 폴리에스터(hyperbranched polyester) 11wt%, 입도가 33 μm 인 알루미나 25wt%, 입도가 24 μm 인 알루미나 30wt%, 입도가 0.5 μm 내지 5 μm 인 알루미나 15wt%를 포블레이션(formulation)한 후 상온에서 5분간 교반하여 실시예 1의 수지 조성물을 얻었다.

[64] <실시예 2>

[65] 화학식 2의 결정성 에폭시 화합물 11wt%, 4, 4'-디아미노디페닐설폰 8wt%, 하이퍼브랜치드 폴리에스터(hyperbranched polyester) 11wt%, 입도가 33 μ m인 알루미늄 20wt%, 입도가 24 μ m인 알루미늄 30wt%, 입도가 0.5 μ m 내지 5 μ m인 알루미늄 20wt%를 포블레이션(formulation)한 후 상온에서 5분간 교반하여 실시예 2의 수지 조성물을 얻었다.

[66] <실시예 3>

[67] 화학식 2의 결정성 에폭시 화합물 11wt%, 4, 4'-디아미노디페닐설폰 8wt%, 하이퍼브랜치드 폴리에스터(hyperbranched polyester) 11wt%, 입도가 33 μ m인 알루미늄 30wt%, 입도가 24 μ m인 알루미늄 20wt%, 입도가 0.5 μ m 내지 5 μ m인 알루미늄 20wt%를 포블레이션(formulation)한 후 상온에서 5분간 교반하여 실시예 3의 수지 조성물을 얻었다.

[68] <실시예 4>

[69] 화학식 2의 결정성 에폭시 화합물 11wt%, 4, 4'-디아미노디페닐설폰 8wt%, 하이퍼브랜치드 폴리에스터(hyperbranched polyester) 11wt%, 입도가 33 μ m인 알루미늄 35wt%, 입도가 24 μ m인 알루미늄 21wt%, 입도가 0.5 μ m 내지 5 μ m인 알루미늄 14wt%를 포블레이션(formulation)한 후 상온에서 5분간 교반하여 실시예 4의 수지 조성물을 얻었다.

[70] <실시예 5>

[71] 화학식 2의 결정성 에폭시 화합물 11wt%, 4, 4'-디아미노디페닐설폰 8wt%, 하이퍼브랜치드 폴리에스터(hyperbranched polyester) 6wt%, 입도가 33 μ m인 알루미늄 50wt%, 입도가 24 μ m인 알루미늄 15wt%, 입도가 0.5 μ m 내지 5 μ m인 알루미늄 10wt%를 포블레이션(formulation)한 후 상온에서 5분간 교반하여 실시예 5의 수지 조성물을 얻었다.

[72] <비교예 1>

[73] 화학식 2의 결정성 에폭시 화합물 11wt%, 4, 4'-디아미노디페닐설폰 8wt%, 하이퍼브랜치드 폴리에스터(hyperbranched polyester) 1wt%, 입도가 33 μ m인 알루미늄 10wt%, 입도가 24 μ m인 알루미늄 10wt%, 입도가 0.5 μ m 내지 5 μ m인 알루미늄 60wt%를 포블레이션(formulation)한 후 상온에서 5분간 교반하여 비교예 1의 수지 조성물을 얻었다.

[74] <비교예 2>

[75] 화학식 2의 결정성 에폭시 화합물 11wt%, 4, 4'-디아미노디페닐설폰 8wt%, 하이퍼브랜치드 폴리에스터(hyperbranched polyester) 16wt%, 입도가 33 μ m인 알루미늄 5wt%, 입도가 24 μ m인 알루미늄 10wt%, 입도가 0.5 μ m 내지 5 μ m인 알루미늄 50wt%를 포블레이션(formulation)한 후 상온에서 5분간 교반하여 비교예 2의 수지 조성물을 얻었다.

[76] <비교예 3>

[77] 화학식 2의 결정성 에폭시 화합물 11wt%, 4, 4'-디아미노디페닐설폰 8wt%,

하이퍼브랜치드 폴리에스터(hyperbranched polyester) 3wt%, 입도가 $24\mu\text{m}$ 인 알루미늄 60wt%, 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄 18wt%를 포물레이션(formulation)한 후 상온에서 5분간 교반하여 비교예 3의 수지 조성물을 얻었다.

- [78] NETZSCH사 제품 LFA447형 열전도율계를 사용하는 비정상 열선법에 의하여 실시예 1 내지 5 및 비교예 1 내지 3의 에폭시 수지 조성물의 열전도율을 측정하였다. 표 1은 그 결과를 나타낸다.

- [79] 표 1

[Table 1]

실험번호	열전도도(W/m.K)
실시예 1	8.0
실시예 2	7.8
실시예 3	8.3
실시예 4	8.9
실시예 5	9.8
비교예 1	3
비교예 2	4
비교예 3	6

- [80] 표 1과 같이, 화학식 2의 결정성 에폭시 화합물 및 4, 4'-디아미노디페닐설폰과 함께 입도가 $33\mu\text{m}$ 인 알루미늄 20wt% 이상, 입도가 $24\mu\text{m}$ 인 알루미늄 10wt% 이상, 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄 10wt% 이상 함유된 실시예 1 내지 5의 수지 조성물은 입도가 $24\mu\text{m}$ 인 알루미늄 10wt% 이상이고, 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄 10wt% 이상이지만, 입도가 $33\mu\text{m}$ 인 알루미늄 20wt% 미만으로 함유된 비교예 1 내지 3의 수지 조성물에 비하여 열전도도가 높음을 알 수 있다.

- [81] 특히, 실시예 3과 같이 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄과 입도가 $24\mu\text{m}$ 인 알루미늄의 함량 비가 1대 1이고, 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄과 입도가 $33\mu\text{m}$ 인 알루미늄의 함량 비가 1대 1.5인 경우, 실시예 4와 같이 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄과 입도가 $24\mu\text{m}$ 인 알루미늄의 함량 비가 1대 1.5이고, 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄과 입도가 $33\mu\text{m}$ 인 알루미늄의 함량 비가 1대 2.5인 경우, 실시예 5와 같이 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄과 입도가 $24\mu\text{m}$ 인 알루미늄의 함량 비가 1대 1.5이고, 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄과 입도가 $33\mu\text{m}$ 인 알루미늄의 함량 비가 1대 5인 경우에는, 실시예 1 또는 2와 같이 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄과 입도가 $24\mu\text{m}$ 인 알루미늄의 함량 비가 1:1 내지 2를 벗어나거나, 입도가 $0.5\mu\text{m}$ 내지 $5\mu\text{m}$ 인 알루미늄과 입도가 $33\mu\text{m}$ 인 알루미늄의 함량 비가 1:1.5 내지 5.5를 벗어나는 수지 조성물에 비하여 열전도도가 특히

높음을 알 수 있다.

- [82] 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

[83]

청구범위

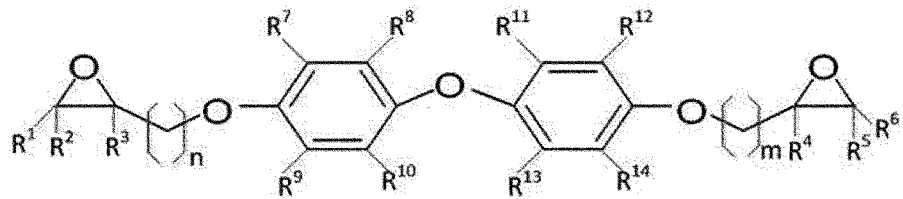
[청구항 1]

하기 화학식 1의 에폭시 화합물, 트리에틸렌디아민, 디페닐포스핀 및 테트라페닐보레이트 중 적어도 하나를 포함하는 수지,
디아미노디페닐설폰, 에틸렌디아민, 디아미노프로판, 메탄디아민, 페닐렌디아민 및 트리에탄올아민 중 적어도 하나를 포함하는 경화제, 그리고

무기 충전재를 포함하고,

상기 무기 충전재는 입자의 크기에 따라 구분된 적어도 2이상의 알루미나(Alumina, Al_2O_3)그룹을 포함하는 수지 조성물:

[화학식 1]



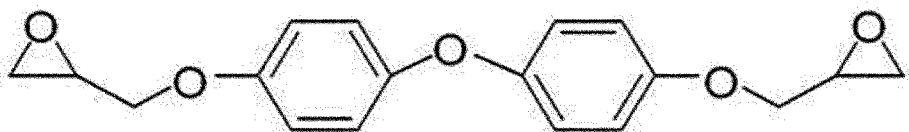
여기서, R^1 내지 R^{14} 은 각각 H, Cl, Br, F, $\text{C}_1\sim\text{C}_3$ 알킬, $\text{C}_2\sim\text{C}_3$ 알켄, $\text{C}_2\sim\text{C}_3$ 알킨으로 구성된 그룹에서 선택될 수 있다. 여기서, m, n은 각각 1, 2 또는 3일 수 있다.

[청구항 2]

제1항에 있어서,

상기 수지는 하기 화학식 2의 에폭시 화합물을 포함하는 수지 조성물:

[화학식 2]



[청구항 3]

제2항에 있어서,

상기 수지 조성물에 대하여 상기 화학식 2의 에폭시 화합물은 3 내지 40 wt%로 포함되고, 상기 경화제는 0.5 내지 30 wt%로 포함되며, 상기 무기 충전재는 40 내지 96.5 중량부wt%로 포함되는 수지 조성물.

[청구항 4]

제3항에 있어서,

상기 무기 충전재는 입도가 $0.1\mu\text{m}$ 이상이고 $10\mu\text{m}$ 미만인 제1 알루미나 그룹, 입도가 $10\mu\text{m}$ 이상이고 $30\mu\text{m}$ 미만인 제2 알루미나 그룹 및 입도가 $30\mu\text{m}$ 이상이고 $60\mu\text{m}$ 이하인 제3 알루미나 그룹을 포함하는 수지 조성물.

[청구항 5]

제4항에 있어서,

상기 제1 알루미나 그룹은 전체 수지 조성물의 10 내지 66.5wt%로

포함되고, 상기 제2 알루미늄 그룹은 전체 수지 조성물의 10 내지 66.5wt%로 포함되며, 상기 제3 알루미늄 그룹은 전체 수지 조성물의 20 내지 76.5wt%로 포함되는 수지 조성물.

[청구항 6]

제4항에 있어서,

상기 제1 알루미늄 그룹과 상기 제2 알루미늄 그룹의 함량 비는 1:1 내지 2이고, 상기 제1 알루미늄 그룹과 상기 제3 알루미늄 그룹의 함량 비는 1:1.5 내지 5.5인 수지 조성물.

[청구항 7]

금속 플레이트,

상기 금속 플레이트 상에 형성되는 절연층, 그리고

상기 절연층 상에 형성되는 회로 패턴을 포함하고,

상기 절연층은 제1항의 수지 조성물로 이루어진 인쇄 회로 기판.

[청구항 8]

제7항에 있어서,

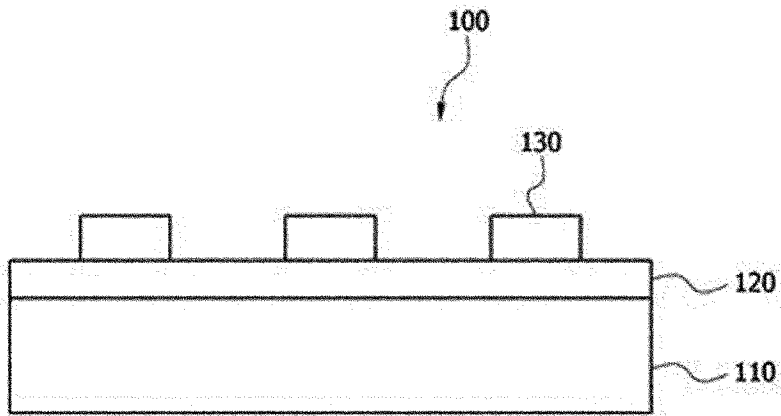
상기 무기 충전제는 입도가 $0.1\mu\text{m}$ 이상이고 $10\mu\text{m}$ 미만인 제1

알루미늄 그룹, 입도가 $10\mu\text{m}$ 이상이고 $30\mu\text{m}$ 미만인 제2 알루미늄

그룹 및 입도가 $30\mu\text{m}$ 이상이고 $60\mu\text{m}$ 이하인 제3 알루미늄 그룹을

포함하는 인쇄 회로 기판.

[Fig. 1]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2013/011312**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER*****C08L 63/00(2006.01)i, C08K 3/22(2006.01)i, C08G 59/22(2006.01)i, H05K 1/03(2006.01)i***

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C08L 63/00; C08G 59/00; C08G 59/62; C08G 59/12; H01B 3/40; C08K 9/00; C08G 59/24; C08K 9/06; C08G 59/14; C08K 3/22; C08G 59/22; H05K 1/03

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: epoxy resin, hardening agent, diaminodiphenylsulfone, inorganic filler, alumina, insulation layer, printed circuit board

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2011-181651 A (PANASONIC CORP.) 15 September 2011 See paragraphs [0001], [0108], [0122], [0129], [0134] and [0136]; claim 1.	1-8
Y	KR 10-2011-0017853 A (EVONIK DEGUSSA GMBH) 22 February 2011 See paragraphs [0001], [0034] and [0045]-[0051]; claims 1, 4.	1-8
A	KR 10-2012-0074109 A (LG INNOTEK CO., LTD.) 05 July 2012 See paragraph [0036]; claims 1, 4, 7-8, 13 and 15.	1-8
A	KR 10-0970906 B1 (DIC CORPORATION) 20 July 2010 See paragraphs [0091], [0157] and [0160].	1-8
A	US 4594291 A (BERTRAM, J. L. et al.) 10 June 1986 See column 7, lines 1-68; column 9, lines 53-55; claim 1.	1-8
A	KR 10-0937918 B1 (SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.) 21 January 2010 See paragraphs [136], [137]; claim 1.	1-8
A	US 2012-0202918 A1 (SINGH, B. et al.) 09 August 2012 See paragraphs [0026], [0041]; claims 1-3.	1-8



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 JANUARY 2014 (24.01.2014)

Date of mailing of the international search report

24 JANUARY 2014 (24.01.2014)

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. 82-42-472-7140

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2013/011312

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
JP 2011-181651 A	15/09/2011	NONE	
KR 10-2011-0017853 A	22/02/2011	CN 102027036 A	20/04/2011
		EP 2119737 A1	18/11/2009
		EP 2119737 B1	04/05/2011
		JP 2011-521033 A	21/07/2011
		TW 201004995 A	01/02/2010
		US 2011-0163461 A1	07/07/2011
		WO 2009-138301 A1	19/11/2009
KR 10-2012-0074109 A	05/07/2012	NONE	
KR 10-0970906 B1	20/07/2010	CN 101384642 A	11/03/2009
		CN 101384642 B	21/12/2011
		CN 101389683 A	18/03/2009
		CN 101389683 B	12/06/2013
		EP 1992653 A1	19/11/2008
		EP 1992653 B1	26/12/2012
		EP 1992655 A1	19/11/2008
		EP 1992655 B1	28/12/2011
		EP 1992655 B9	07/03/2012
		JP 04259536 B2	30/04/2009
		JP 04285491 B2	24/06/2009
		JP 2007-231083 A	13/09/2007
		JP 2007-262013 A	11/10/2007
		KR 10-0975846 B1	16/08/2010
		US 2009-0088535 A1	02/04/2009
		US 2009-0099303 A1	16/04/2009
		WO 2007-099670 A1	07/09/2007
		WO 2007-099674 A1	07/09/2007
US 4594291 A	10/06/1986	EP 0187855 A1	23/07/1986
		EP 0187855 B1	10/02/1993
		EP 0328020 A3	12/12/1990
		EP 0328020 B1	09/10/1996
		EP 0553887 A2	04/08/1993
		JP 01-308423 A	13/12/1989
		JP 02721225 B2	04/03/1998
		KR 10-1989-0013083 A	21/09/1989
		KR 10-1990-0006912 B1	24/09/1990
		KR 10-1992-0000925 B1	31/01/1992
		US 04925901 A	15/05/1990
		US 04946817 A	07/08/1990
		US 05134239 A	28/07/1992
		US 05503937 A	02/04/1996
		US 4725652 A	16/02/1988
		WO 86-00627 A1	30/01/1986
KR 10-0937918 B1	21/01/2010	JP 04967212 B2	04/07/2012

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2013/011312

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
US 2012-0202918 A1	09/08/2012	JP 2003-107693 A	09/04/2003
		JP 2003-107694 A	09/04/2003
		TW 1305292 A	11/01/2009
		TW 1305292 B	11/01/2009
		CN 102695739 A	26/09/2012
		EP 2470583 A1	04/07/2012
		US 8399577 B2	19/03/2013
		WO 2011-023227 A1	03/03/2011

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

C08L 63/00(2006.01)i, C08K 3/22(2006.01)i, C08G 59/22(2006.01)i, H05K 1/03(2006.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

C08L 63/00; C08G 59/00; C08G 59/62; C08G 59/12; H01B 3/40; C08K 9/00; C08G 59/24; C08K 9/06; C08G 59/14; C08K 3/22; C08G 59/22; H05K 1/03

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))

eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 에폭시 수지, 경화제, 디아미노디페닐설폰, 무기 충전제, 알루미늄, 절연층, 인쇄 회로 기판

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
Y	JP 2011-181651 A (PANASONIC CORP.) 2011.09.15 문단 [0001], [0108], [0122], [0129], [0134], [0136]; 청구항 1 참조.	1-8
Y	KR 10-2011-0017853 A (에보닉스 테크놀로지) 2011.02.22 문단 [0001], [0034], [0045]-[0051]; 청구항 1, 4 참조.	1-8
A	KR 10-2012-0074109 A (엘지이노텍 주식회사) 2012.07.05 문단 [0036]; 청구항 1, 4, 7-8, 13, 15 참조.	1-8
A	KR 10-0970906 B1 (디아이씨 가부시끼가이샤) 2010.07.20 문단 [0091], [0157], [0160] 참조.	1-8
A	US 4594291 A (BERTRAM, J. L. 외 3인) 1986. 06. 10 컬럼 7, 라인 1-68; 컬럼 9, 라인 53-55; 청구항 1 참조.	1-8
A	KR 10-0937918 B1 (스미토모 가가꾸 가부시끼가이샤) 2010.01.21 문단 [136], [137]; 청구항 1 참조.	1-8
A	US 2012-0202918 A1 (SINGH, B. 외 3인) 2012.08.09 문단 [0026], [0041]; 청구항 1-3 참조.	1-8



추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.



대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

“A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

“T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

“E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

“X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

“L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

“Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

“O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

“&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

“P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

국제조사의 실제 완료일

2014년 01월 24일 (24.01.2014)

국제조사보고서 발송일

2014년 01월 24일 (24.01.2014)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소

 대한민국 특허청
(302-701) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)

팩스 번호 +82-42-472-7140

심사관

김동석

전화번호 +82-42-481-8647



국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
JP 2011-181651 A	2011/09/15	없음	
KR 10-2011-0017853 A	2011/02/22	CN 102027036 A EP 2119737 A1 EP 2119737 B1 JP 2011-521033 A TW 201004995 A US 2011-0163461 A1 WO 2009-138301 A1	2011/04/20 2009/11/18 2011/05/04 2011/07/21 2010/02/01 2011/07/07 2009/11/19
KR 10-2012-0074109 A	2012/07/05	없음	
KR 10-0970906 B1	2010/07/20	CN 101384642 A CN 101384642 B CN 101389683 A CN 101389683 B EP 1992653 A1 EP 1992653 B1 EP 1992655 A1 EP 1992655 B1 EP 1992655 B9 JP 04259536 B2 JP 04285491 B2 JP 2007-231083 A JP 2007-262013 A KR 10-0975846 B1 US 2009-0088535 A1 US 2009-0099303 A1 WO 2007-099670 A1 WO 2007-099674 A1	2009/03/11 2011/12/21 2009/03/18 2013/06/12 2008/11/19 2012/12/26 2008/11/19 2011/12/28 2012/03/07 2009/04/30 2009/06/24 2007/09/13 2007/10/11 2010/08/16 2009/04/02 2009/04/16 2007/09/07 2007/09/07
US 4594291 A	1986/06/10	EP 0187855 A1 EP 0187855 B1 EP 0328020 A3 EP 0328020 B1 EP 0553887 A2 JP 01-308423 A JP 02721225 B2 KR 10-1989-0013083 A KR 10-1990-0006912 B1 KR 10-1992-0000925 B1 US 04925901 A US 04946817 A US 05134239 A US 05503937 A US 4725652 A WO 86-00627 A1	1986/07/23 1993/02/10 1990/12/12 1996/10/09 1993/08/04 1989/12/13 1998/03/04 1989/09/21 1990/09/24 1992/01/31 1990/05/15 1990/08/07 1992/07/28 1996/04/02 1988/02/16 1986/01/30
KR 10-0937918 B1	2010/01/21	JP 04967212 B2	2012/07/04

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
		JP 2003-107693 A	2003/04/09
		JP 2003-107694 A	2003/04/09
		TW I305292 A	2009/01/11
		TW I305292 B	2009/01/11
US 2012-0202918 A1	2012/08/09	CN 102695739 A	2012/09/26
		EP 2470583 A1	2012/07/04
		US 8399577 B2	2013/03/19
		WO 2011-023227 A1	2011/03/03